

锦州神工半导体股份有限公司

2023 年年度业绩预告

本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 经财务部门初步测算，锦州神工半导体股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2023 年年度实现营业收入为 13,500.00 万元到 14,500.00 万元，与上年同期相比减少 39,423.65 万元到 40,423.65 万元，同比减少 73%到 75%。

● 预计 2023 年年度归属于母公司所有者的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损，实现归属于母公司所有者的净利润-6,700.00 万元到 -7,700.00 万元，同比减少 142%到 149%。

● 预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-7,000.00 万元到-8,000.00 万元，同比减少 145%到 152%。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

（二）业绩预告情况

1、经财务部门初步测算，预计 2023 年年度实现营业收入为 13,500.00 万元到 14,500.00 万元，与上年同期相比，将减少 39,423.65 万元到 40,423.65 万元，同比减少 73%到 75%。

2、公司预计 2023 年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-6,700.00 万元到-7,700.00 万元，与上年同期相比，将减少 22,514.16 万元到 23,514.16 万元，同比减少 142%到 149%。

3、公司预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-7,000.00万元到-8,000.00万元，与上年同期相比，将减少22,473.66万元到23,473.66万元，同比减少145%到152%。

(三) 本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

2022年度，公司实现营业收入53,923.65万元，归属于母公司所有者的净利润为15,814.16万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为15,473.66万元。

三、本期业绩变化的主要原因

公司2023年业绩较去年同期下滑，由盈转亏，主要原因是：

(一) 本报告期内，受行业周期影响，公司大直径硅材料业务收入较上年大幅下降，产能利用率下滑，导致公司整体净利润较上年大幅下滑；

(二) 目前公司硅零部件和硅片业务正处在市场开拓期，但其收入和利润增长规模和速度有限；同时，本报告期内计提了存货跌价准备，也导致了公司净利润的下降。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，尚未经注册会计师审计。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2023年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

锦州神工半导体股份有限公司董事会

2024年1月30日